

RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:

- 90°, liegend (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
- Rasthaken oben und unten (latch up / latch down)
- THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
- Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierten LED´s und Schirm-Kontaktfahnen
- Performance Kategorie von Cat.3 bis Cat.6
- Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
- Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603
- Spannungsfestigkeit $\geq 1500V$ AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3
- Spannungsfestigkeit $\geq 1500V$ AC (Scheitelwert) oder $\geq 1500V$ DC gemäß IEC 60603

Eigenschaften und Vorteile:

- Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis $+85$ °C, für maximale Leistungsfähigkeit
- Verstärkte Goldschicht (30μ) für verbesserten Korrosionsschutz
- Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: oben, LED: Ja, grün, gelb, Polzahl: 8, Tape |
| Best.-Nr. | 2626090000 |
| Typ | RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL |
| GTIN (EAN) | 4050118630183 |
| VPE | 240 Stück |
| Verpackung | Tape |

RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|----------------------|------------|--------------|------------|
| Tiefe | 15,7 mm | Tiefe (inch) | 0,618 inch |
| Höhe | 13,1 mm | Höhe (inch) | 0,516 inch |
| Höhe niedrigstbauend | 16,5 mm | Breite | 16,4 mm |
| Breite (inch) | 0,646 inch | Nettogewicht | 8,408 g |

Elektrische Eigenschaften

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ | Nennspannung | 125 V |
| Nennstrom | 1.5 A | PoE / PoE+ | gemäß IEEE 802.3at |
| Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt | 1000 V DC | Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm | 1500 V DC |

Systemkennwerte

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Abgangswinkel | 90° | Anschlussart | Lötanschluss |
| Durchlassspannung, max. | 2,6 V | Durchlassspannung, min. | 1,8 V |
| Durchlassstrom | 20 mA | Farbe LED links | grün |
| Farbe LED rechts | gelb | LED | Ja |
| Lötstift-Abmessungen | oktogonal | Lötstiftlänge (l) | 1,7 mm |
| Lötstiftposition-Toleranz | ± 0,1 mm | Lötverfahren | Reflow-Löten, Handlöten, Wellenlöten |
| Montage auf der Leiterplatte | THT/THR-Lötanschluss | Polzahl | 8 |
| Produktfamilie | OMINMATE Data – Modulare RJ45-Buchse | Raster in Zoll (P) | 0,04 " |
| Raster in mm (P) | 1,02 mm | Riegel-Option | oben |
| Schirmoberfläche | vernickelt | Schirmung | Ja |
| Schutzart | IP20 | Steckzyklen | 750 |

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| Isolierstoff | PA 9T | Farbe | schwarz |
| Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 | Isolierstoffgruppe | II |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ | Moisture Level (MSL) | 1 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Kontaktbasismaterial | Phosphor-Bronze Legierung |
| Kontaktmaterial | Cu-leg | Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C | Lagertemperatur, max. | 85 °C |
| Betriebstemperatur, min. | -40 °C | Betriebstemperatur, max. | 85 °C |

Verpackungen

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| Verpackung | Tape | VPE Länge | 359 mm |
| VPE Breite | 354 mm | VPE Höhe | 128 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002637 | ETIM 7.0 | EC002637 |
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Certificate of Compliance](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

| Code | Value | Description |
|----------------------------------|--------------------|---|
| RJ45 | G1 | RJ45G1 |
| R1 | R | R1R |
| U | U | U |
| 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| E | E | E |
| 4 | 4 | 4 |
| GY/GY | GY/GY | GY/GY |
| TY | TY | TY |
| RJ45G1 R1U 3.2E4G/Y TY | | |
| Packaging | TY | Tray in box (manual assembly) |
| | RL | Tape on Reel (automated assembly) |
| LED | Y/G | Yellow/Green |
| | G/Y | Green/Yellow (standard) |
| | GY/GY | Green-Yellow/Green-Yellow |
| | O/G | Orange/Green |
| | R/O | Red/Orange |
| | ... | ... (further combinations possible) |
| | N | without LED |
| Contact surface thickness | 4 | 1 = 3µ, 2 = 6µ, 3 = 15µ, 4 = 30µ, 5 = 50µ |
| EMI tabs (ground fingers) | E | E = with EMI tabs |
| | N | N = without EMI tabs |
| Solder Pin length | 3.2 | 3.2 mm |
| | 1.6 | 1.6 mm |
| | D | SMD |
| Direction, latch style | U | Horizontal (90°, side entry), latch up |
| | D | Horizontal (90°, side entry), latch down |
| | V | Vertical (180°, top entry) |
| | Y | Diagonal (45°), latch up |
| Number of Ports | 1 | 1 Port |
| | 12; 14; ... | multi ports side by side, Multiport |
| | 21; 41; ... | multi ports about each other, Multilevel |
| Assembly on PCB | R | Through Hole Reflow - THR |
| | S | Soldering process: Wave or Reflow soldering |
| | S | Surface Mount Technology - SMT |
| | T | Soldering process: Reflow soldering |
| | T | Through Hole Technology - THT |
| | T | Soldering process: Wave |
| Performance Category | C5 | Category 5 |
| | C6 | Category 6 |
| | C6A | Category 6A |
| | C5e | Category 5e |
| | M | 10/100 Mbit |
| | G1 | 10/100/1000 Mbit |
| | G10 | 10 Gbit |
| | U | Unshielded |
| | MP | 10/100 Mbit with POE |
| | MP+ | 10/100 Mbit with POE+ |

Legende

Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

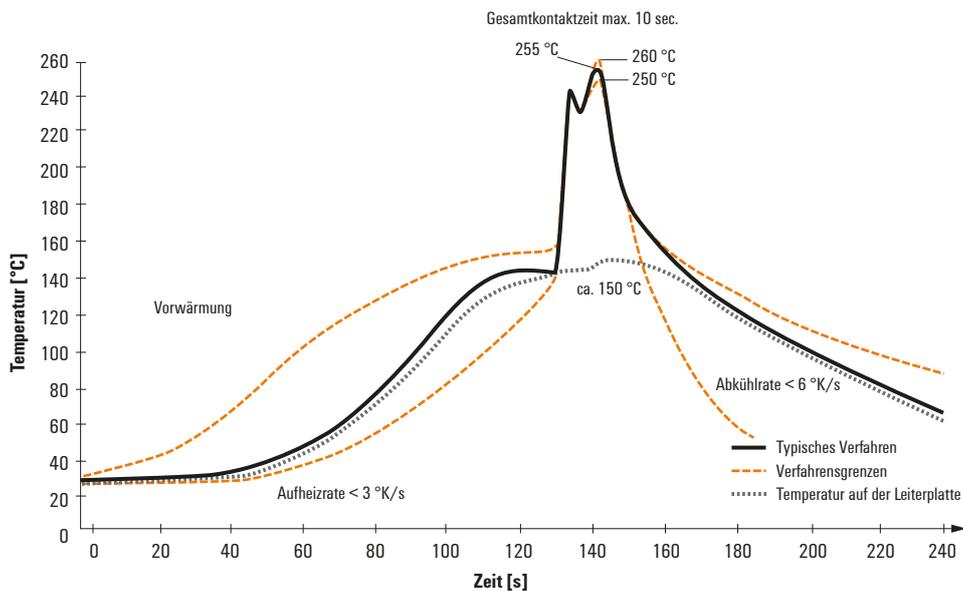
Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlüsselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezogene Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unter anderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3$ K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste ‚aktiviert‘. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.